

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail:

- im Umschlag an die vorgedruckte Adresse
- per E-Mail an feldmann@faps-tt.de
- per Fax an 0911.58058.30

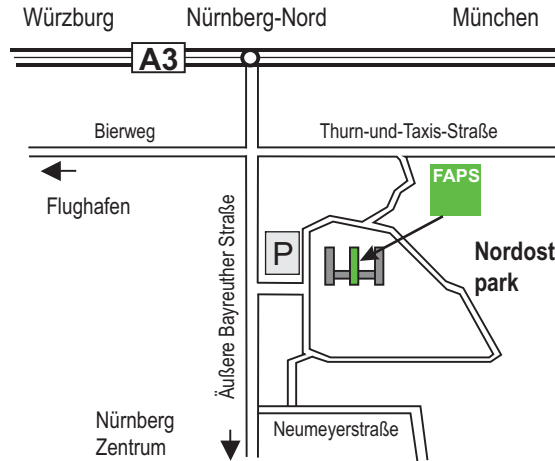
Titel, Vorname, Name	
Firma	
Abteilung	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	Telefax
E-Mail	
Datum, Unterschrift	

**Ich melde mich an für das Fachseminar
"Aktuelle Entwicklungen zur Aufbau- und
Verbindungstechnik", 28.11.2006, Nürnberg**

Antwort

Prof. Dr.-Ing. K. Feldmann, Inh.
LS Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik -FAPS
- Elektronikproduktion -

Nordostpark 91
90411 Nürnberg



Veranstaltungsort:

Das Seminar und die Laborpräsentation finden in der neuen Forschungsfabrik Nürnberg, Nordostpark 89-91, mit dem Schwerpunktlabor Elektronikproduktion statt.

Anmeldung:

Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung mit Vorlage der Anmeldebestätigung. Verwenden Sie bitte zur Anmeldung die vorgedruckte Antwortkarte. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Registrierung erfolgt nach Eingangsdatum.

Teilnahmegebühr und Leistungen:

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 340,- € zzgl. MwSt. ist nach Rechnungsstellung auf das dort angegebene Konto zu überweisen und schließt Tagungsunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen mit ein.

Rücktritt:

Bei Rücktritt bis zu 10 Tagen vor dem Seminar erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50 €. Nach dieser Frist ist die Teilnahmegebühr gemäß Rechnung zu zahlen. Die Seminarunterlagen werden dann zugesandt.

Weitere Informationen:

Dipl.-Ing. M. Rösch
Telefon: 0911.58058.21
Telefax: 0911.58058.30
E-Mail: roesch@faps.uni-erlangen.de

Veranstalter:

FAPS-TT GmbH, Erlangen

Fachseminar zur
Elektronikproduktion

**Aktuelle Entwicklungen zur
Aufbau- und Verbindungstechnik**

- Beherrschung feinsten Strukturen in komplexen Baugruppen
- Optimierte Systemlösungen zum flexiblen Bestücken
- Angepasste Prozesse für den Einsatz bleifreier Lotwerkstoffe
- Ganzheitliche Qualitätssicherung entlang der Prozesskette

28. November 2006

Nürnberg
Forschungsfabrik
Nordostpark 89-91

Fachliche Leitung:

Prof. Dr.-Ing. K. Feldmann, Inh.
LS Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik,
Universität Erlangen-Nürnberg

Entwicklungen zur Aufbau- und Verbindungstechnik

Die weitere Miniaturisierung elektronischer Bauelemente, die schnelle Einführung neuartiger Schaltungsträger und alternativer Verbindungstechnologien sowie die Umstellung auf bleifreie Lote führen zu ganz neuen Herausforderungen in der Elektronikproduktion. Für die Aufbau- und Verbindungstechnik gilt es, Anlagen und Prozesse anzupassen oder neu zu entwickeln. Diese weiterführende Optimierung erfordert innovative Strategien und neuartige Konzepte.

Im Rahmen dieses Seminars stellen erfahrene Experten aus Industrie und Forschung neue Ansätze zur Technologieoptimierung und ihre Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung vor. Entlang der Prozesskette Lotpastenauftrag, Bestücken, Löten werden aktuelle Schwerpunkte gesetzt sowie Strategien zur ganzheitlichen Qualitätssicherung vorgestellt.



Ziel der Veranstaltung ist es, einen aktuellen Informationstransfer mit Vorträgen, ergänzenden Fachdiskussionen sowie den Vorführungen in den Labors zu bieten. Das Forum in der Forschungsfabrik Nürnberg im Nordostpark mit dem Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion bietet dazu beste Möglichkeiten.

Das Tagesprogramm bietet auch Gelegenheit zur Diskussion individueller Problemstellungen und spezifischer Sachfragen zur Elektronikproduktion.

Programm

- 09:00 **Ganzheitliche Optimierung und gesicherte Teilprozesse in der Baugruppenmontage**
Prof. K. Feldmann
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Lösungen für neue Herausforderungen**
- 09:40 **Konzepte zur Integration neuer Technologien bei elektronischen Baugruppen in der Kfz-Elektronik**
Dr. A. Brand
Conti Temic microelectronic GmbH, Ingolstadt
- 10:20 **LTCC, die Substrattechnologie für hochintegrierte und hochzuverlässige Mikrosysteme**
C. Zeilmann
MSE GmbH & Co., Berg/Oberfranken
- 11:00 *Kaffeepause*
- Flexibel und präzise Bestücken**
- 11:20 **Qualifizierung der Montage elektrooptischer Bauelemente am Beispiel einer modifizierten Prozesskette**
D. Craiovan
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 12:00 **Gesicherte Bestückprozesse bei hochflexiblen Kundenaufträgen**
M. Tillmann
Schlafhorst Electronics GmbH, Mönchengladbach
- 12:30 *Mittagspause*
- Lotpasten und gesicherte Lötprozesse**
- 13:40 **Herstellerabhängige Varianz im Eigenschaftsprofil bleifreier SAC-Legierungen**
M. Rösch
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- 14:20 **Randbedingungen für einen zuverlässigen Lötprozess**
G. Diepstraten
Vitronics Soltec BV, Oosterhout/Niederlande
- 15:00 *Kaffeepause*

Programm

- Sicherung von Qualität und Zuverlässigkeit**
- 15:20 **Umwelterprobung zur Zuverlässigkeitsabsicherung bei Kfz-Elektronik**
G. Vogl
Siemens VDO, Regensburg
- 16:20 **Verarbeitungseigenschaften von No Flow Underfillern bei hochminiaturisierten Baugruppen**
A. Reinhardt
Lehrstuhl FAPS, Universität Erlangen-Nürnberg
- Systemlösungen entwickeln und erproben**
- 16:30 **Laborpräsentationen**
im neuen Schwerpunktlabor zur Elektronikproduktion mit temperierter Versuchshalle, Reinraum und Prüflabors: Alternative Systemlösungen zum Lotpastenauftrag, Bestücken und Löten mit prozessbegleitender Qualitätssicherung. Verschiedene Werkzeuge zur Nacharbeit. Präsentation der Ergebnisse aktueller Verbundprojekte zur Elektronikproduktion.
- 17:40 **Abschlussdiskussion**



Falls Sie spezifische Fragen oder Interessen haben - nennen Sie uns eventuell Ihre Anliegen vorab, wir werden dies bei den Laborpräsentationen und in den begleitenden Fachgesprächen gern berücksichtigen!